

## 半導体後工程の自動化技術研究組合（SATAS）に参画

～ 先端パッケージに関する、専門知識・経験を活用し技術開発を加速 ～

株式会社レゾナック（社長：高橋秀仁、以下、当社）は、半導体製造のパッケージング・アセンブリーやテスト工程（以下、後工程）の自動化を目的とする「半導体後工程自動化・標準化技術研究組合」（以下、SATAS）に参画いたしました。

SATAS は半導体・製造装置・搬送装置メーカー、標準化団体等 15 の企業と団体で構成され、4 月 16 日に設立されました。SATAS は、後工程の自動化技術および標準仕様の確立、装置開発とパイロットライン検証を行い、2028 年に後工程の完全自動化システムの実用化を目指します。

当社は半導体材料メーカーとして、先端パッケージと後工程の研究開発で得た知識・経験を活用し、SATAS の技術開発を加速させます。

現在、急拡大中の生成 AI や自動運转向けの高性能半導体では、2.xD や 3D<sup>※1</sup> パッケージなど後工程のパッケージング技術<sup>※1</sup> がキーテクノロジーとして進化し続けています。一方で、後工程の製造ラインは各工程間の搬送・受け渡しを人が行っているケースが多く、後工程の自動化が急務とされています。

当社は、後工程材料でトップシェアの製品を多数揃えるとともに、先端パッケージを実際に製作できる研究開発拠点「パッケージングソリューションセンター」<sup>※2</sup> を川崎市に設け、後工程全体の研究開発に取り組んでいます。研究開発で培った知識・経験を活用して、SATAS の組立工程と検査工程を対象としたプロセス開発に貢献していきます。

※1 2.xD パッケージはインターポザー上に IC チップを並列配置する技術。

3D パッケージは TSV（シリコン貫通電極）を用いてチップを積層する技術。

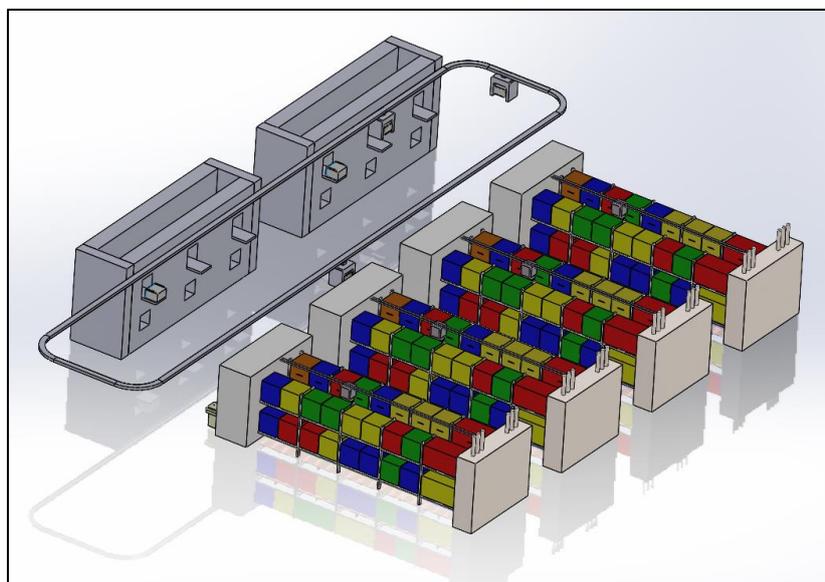
※2 最先端の後工程装置をフルラインナップで備える、パッケージング技術・評価技術に関するオープンイノベーション・研究開発拠点。

### SATAS 概要

設立日	2024年4月16日
理事会	理事長：鈴木 国正（インテル株式会社 代表取締役社長）

	<p>理事：高橋 知樹（株式会社三菱総合研究所 全社連携事業推進本部 情報通信分野担当本部長）</p>
	<p>理事：浜島 雅彦（有限会社セミ・ジャパン 代表取締役）</p>
	<p>監事：三尾 美枝子（紀尾井町法律事務所 弁護士）</p>
<p>組合員 * 50音順</p>	<p>インテル株式会社 オムロン株式会社 シャープ株式会社 信越ポリマー株式会社 シンフォニアテクノロジー株式会社 有限会社セミ・ジャパン 株式会社ダイフク 平田機工株式会社 株式会社 FUJI 株式会社三菱総合研究所 ミライアル株式会社 村田機械株式会社 ヤマハ発動機株式会社 株式会社レゾナック・ホールディングス ローツエ株式会社</p>
<p>体制</p>	
<p>本部所在地</p>	<p>東京都千代田区永田町 2-10-3 株式会社三菱総合研究所内</p>

事業内容	半導体後工程の自動化・標準化に係る研究開発を推進。半導体生産の経済性に大きな影響を及ぼすことになる後工程に着目し、省力化・自動化推進に必要な装置・システム間の標準化を進め、プロト、商用モデル、パイロットラインでの検証を行う。
------	--



半導体後工程自動化パイロットラインのイメージ

以上

#### 【Resonac（レゾナック）グループについて】

レゾナックグループは、2023年1月に昭和電工グループと昭和電工マテリアルズグループ（旧日立化成グループ）が統合してできた新会社です。半導体・電子材料の売上高は、約3,400億円に上り、特に半導体の「後工程」材料では世界No.1の企業です。2社統合により、材料の機能設計はもちろん、自社内で原料にまでさかのぼって開発を進めています。新社名の「Resonac」は、英語の「RESONATE：共鳴する・響き渡る」と、Chemistryの「C」の組み合わせです。今後さらに共創プラットフォームを生かし、国内外の半導体メーカー、材料・装置メーカーとともに技術革新を加速させます。詳しくはウェブサイトをご覧ください。

株式会社レゾナック・ホールディングス <https://www.resonac.com/jp/>

#### ◆ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社レゾナック・ホールディングス

ブランド・コミュニケーション部 メディアリレーショングループ

TEL 03-6263-8002